

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年1月15日(2015.1.15)

【公開番号】特開2013-125855(P2013-125855A)

【公開日】平成25年6月24日(2013.6.24)

【年通号数】公開・登録公報2013-033

【出願番号】特願2011-273631(P2011-273631)

【国際特許分類】

H 05 K	1/02	(2006.01)
H 05 K	3/00	(2006.01)
B 23 K	26/364	(2014.01)
B 23 K	26/00	(2014.01)
C 04 B	41/91	(2006.01)

【F I】

H 05 K	1/02	G
H 05 K	3/00	N
H 05 K	3/00	X
B 23 K	26/00	D
B 23 K	26/00	H
C 04 B	41/91	E

【手続補正書】

【提出日】平成26年11月20日(2014.11.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

平面視において延設方向に沿っている直線部を有して底面には凹凸を有する溝部を、備えていることを特徴とするセラミック基板。

【請求項2】

前記溝部が交差している交差領域を有し、

前記交差領域の底面は、前記溝部が交差していない領域の底面よりも、前記表面との間の距離が大きいことを特徴とする請求項1に記載のセラミック基板。

【請求項3】

前記溝部の底面は、前記溝部の延設方向に凹凸が連続して配置されている形状であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のセラミック基板。

【請求項4】

請求項1ないし請求項3の何れか一項に記載のセラミック基板から分割して取得した基板と、

電子部品と、を備えていることを特徴とする電子デバイス。

【請求項5】

請求項1ないし請求項3の何れか一項に記載のセラミック基板から分割して取得した基板を備えていることを特徴とする電子機器。

【請求項6】

請求項1から請求項3の何れか一項に記載のセラミック基板に電子部品を搭載する工程と、

前記電子部品を搭載した後に前記セラミック基板を分割する工程と、
を含むことを特徴とする電子デバイスの製造方法。_____

【請求項 7】

請求項 1 から請求項 3 の何れか一項に記載のセラミック基板から分割して取得した基板
に電子部品を搭載する工程を含むことを特徴とする電子デバイスの製造方法。_____

【請求項 8】

セラミック基板の表面にレーザーを照射して溝部を形成する方法であって、
平面視による形状が直線部を含む側面を形成する側面形成工程と、
底面に凹凸を形成する底面加工工程と、
を含むことを特徴とするセラミック基板の製造方法。